

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Designed for Intel, AMD, Via, Freescale, NVidia and Texas Instrument processors that employ a BGA socket

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

Patent pending conduction cooling solution for small form factor electronics

Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Compatible with Interscale C enclosures

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Förpackningskvantitet	Djup	Bredd
---------------	-----	---------------	-----------------------	------	-------

24830-005	Värmeledare	Fall	1	22 mm	22 mm
-----------	-------------	------	---	-------	-------

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE